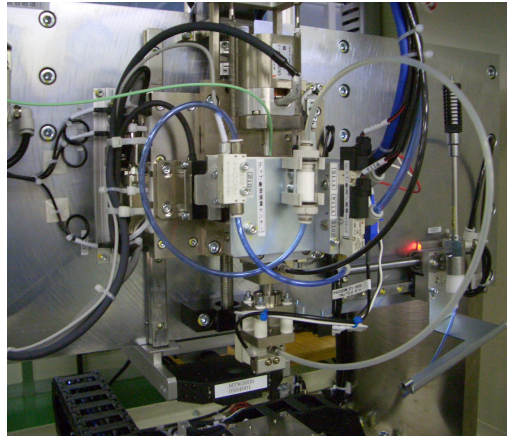
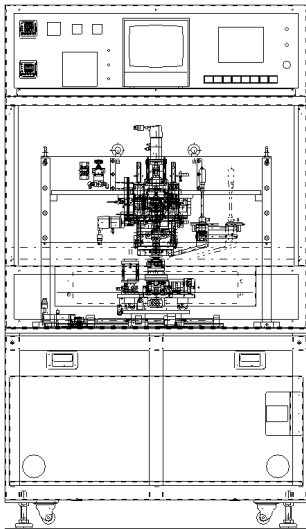


### ■ 装置概要

本機は、リジッド基板へのチップ実装や COC (チップ・オン・チップ) 実装のハンダマイクロボンパ加熱加圧接合に適したスタンドアロンタイプのチップボンダーである。



### ■ 主な特長

1. 0.05N (5g) ±10%の高精度超低加圧を実現
  - ◇ 荷重分解能を大幅にアップした電流フィードバック型加圧ユニットと新推力コントローラーを開発、採用
  - ◇ 摺動抵抗レスのエアスライダーユニットを採用
  - ◇ 超高感度の荷重検出素子をリニア配列し、加圧力を高速フィードバック
2. 多段階温度制御可能なNEWセラミックヒーターヘッドを搭載  
温度モニタリング、荷重モニタリング機能付

### ■ 簡易仕様

1. □0.5mm～□10mm チップに対応可
2. Max□60mm 基板に対応可
3. 圧着ステージ上にチップをフェースダウンし、基板を外形基準で置き、上下2視野カメラを利用して、マニュアルアライメントさせることが可能

[お問い合わせ先]

 **大崎エンジニアリング株式会社**

□本社営業部           04-2934-3411  
□東京営業部           03-3280-5771

<http://www.oec-inc.co.jp>